

# 2025年度 (2026年3月期) 決算説明会

2026/05/13

## 株式会社東京精密

代表取締役社長CEO

取締役 半導体社 執行役員カンパニー長

計測社 執行役員カンパニー長

執行役員常務 CFO

木村 龍一

伯耆田 貴浩

石川 一政

小泉 公人

- 将来の事象に係わる記述に関する注意：** 本資料に記載されている情報、ならびに口頭で提供される情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは、市況、競争状況、半導体業界、ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
- 用語について：** 注記がある場合を除き、半導体製造装置セグメントを「半導体」、精密計測機器セグメントを「計測」、親会社株主に帰属する当期純利益を「当期純利益」、中期経営計画を「中計」と記載します。
- 記入データについて：** 記載されている金額や比率の情報は「億円」、またはパーセント(%)による要約表示を行っております。その為、内訳の計が合計と一致しない場合があります。
- 監査について：** 本プレゼンテーション資料は、監査法人による監査の対象外です。

# エグゼクティブサマリー

## 2025年度 業績

- ・ 売上高は1,668億円(前期比+11%、既往ピーク更新)、受注高は1,631億円(同+12%)、半導体製造装置(以下 半導体) でHPC向けが牽引
- ・ 純利益は前期比ほぼ横ばい、年間配当 1株262円(同+9円)を予想

## 中期経営計画 初年度総括

- ・ 「長期成長に向けた準備」と「期間の成長」の両立を推進
- ・ 「戦略製品の成長促進」を進め、高付加価値プローバを展開
- ・ 生産キャパシティ拡張に向けた取り組みも推進

## 2026年度 業績予想

- ・ 半導体、計測機器とも中期経営計画の前提に沿った環境を想定
- ・ HPCの強い需要、付加価値製品の拡大が増収増益に貢献
- ・ 利益率の上昇も見込む

# 2025年度 連結業績

売上高は既往ピークを更新、営業利益・経常利益も増加

全社業績(億円)		2024年度	2025年度	2月予想比	前期比
受注高		1,456	1,631	-	+12%
売上高		1,505	1,668	+18	+11%
営業利益		297	337	+17	+14%
(利益率)		(20%)	(20%)	-	+0pt
経常利益		299	348	+28	+16%
当期純利益		256	247	+32	-4%
研究開発費		104	120	+0	+16%
設備投資		102	111	-9	+8%
減価償却費		51	56	+1	+9%
1株配当(円)		253円	262円	+40円	+9円
セグメント別業績		2024年度	2025年度	2月予想比	前期比
半導体 製造装置	受注高	1,077	1,234	-	+15%
	売上高	1,135	1,279	+4	+13%
	営業利益	243	284	-	+17%
	(利益率)	(21%)	(22%)	-	+1pt
計測機器	受注高	379	397	-	+5%
	売上高	371	390	+15	+5%
	営業利益	54	53	-	-1%
	(利益率)	(15%)	(14%)	-	-1pt

# 2025年度 第4四半期 連結業績

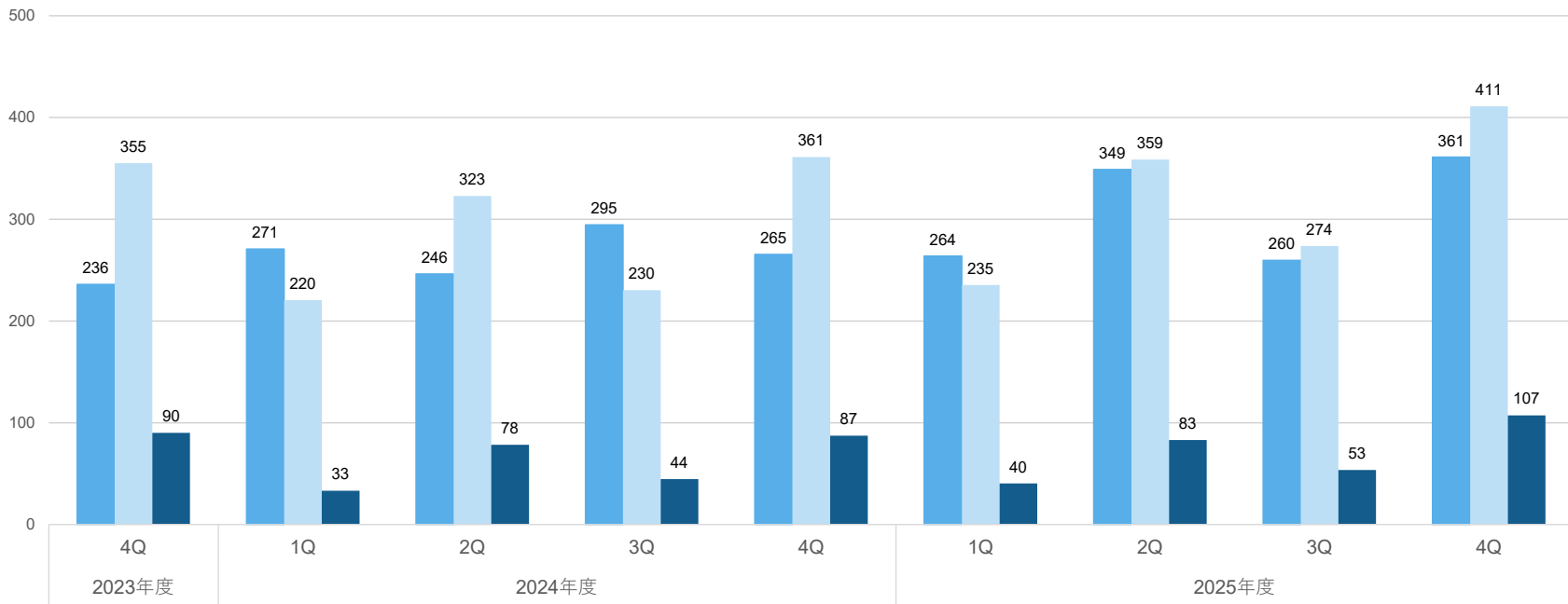
四半期売上は既往ピークを更新、利益率も上昇

全社業績(億円)		2024年度				2025年度				4Q	前四半期比	前年同期比
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q			
受注高		374	337	392	353	359	447	366	458		+25%	+30%
売上高		296	418	317	474	309	462	359	539		+50%	+14%
営業利益		41	93	57	106	46	101	62	128		+106%	+20%
(利益率)		(14%)	(22%)	(18%)	(22%)	(15%)	(22%)	(17%)	(24%)		+7pt	+1pt
経常利益		43	88	66	101	45	105	67	131		+95%	+29%
当期純利益		36	100	46	75	32	64	45	106		+133%	+41%
研究開発費		23	28	25	28	25	30	29	36		+21%	+29%
設備投資		28	12	24	39	25	44	15	27		+78%	-31%
減価償却費		12	13	13	13	12	14	14	16		+7%	+13%
セグメント別業績		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		前四半期比	前年同期比
半導体製造装置	受注高	271	246	295	265	264	349	260	361		+39%	+36%
	売上高	220	323	230	361	235	359	274	411		+50%	+14%
	営業利益	33	78	44	87	40	83	53	107		+101%	+23%
	(利益率)	(15%)	(24%)	(19%)	(24%)	(17%)	(23%)	(20%)	(26%)		+7pt	+2pt
計測機器	受注高	103	91	98	87	95	98	107	97		-9%	+12%
	売上高	76	95	87	113	73	103	85	128		+50%	+13%
	営業利益	8	15	12	19	5	18	9	21		+140%	+9%
	(利益率)	(10%)	(16%)	(14%)	(17%)	(7%)	(18%)	(10%)	(16%)		+6pt	-1pt

# 半導体製造装置セグメント 業績推移

第4四半期の受注高は、HPC向けで想定線、他案件での上振れとなり、  
受注残高の一部整理(約10億円マイナス)があるなかでも想定をやや上回る着地となった

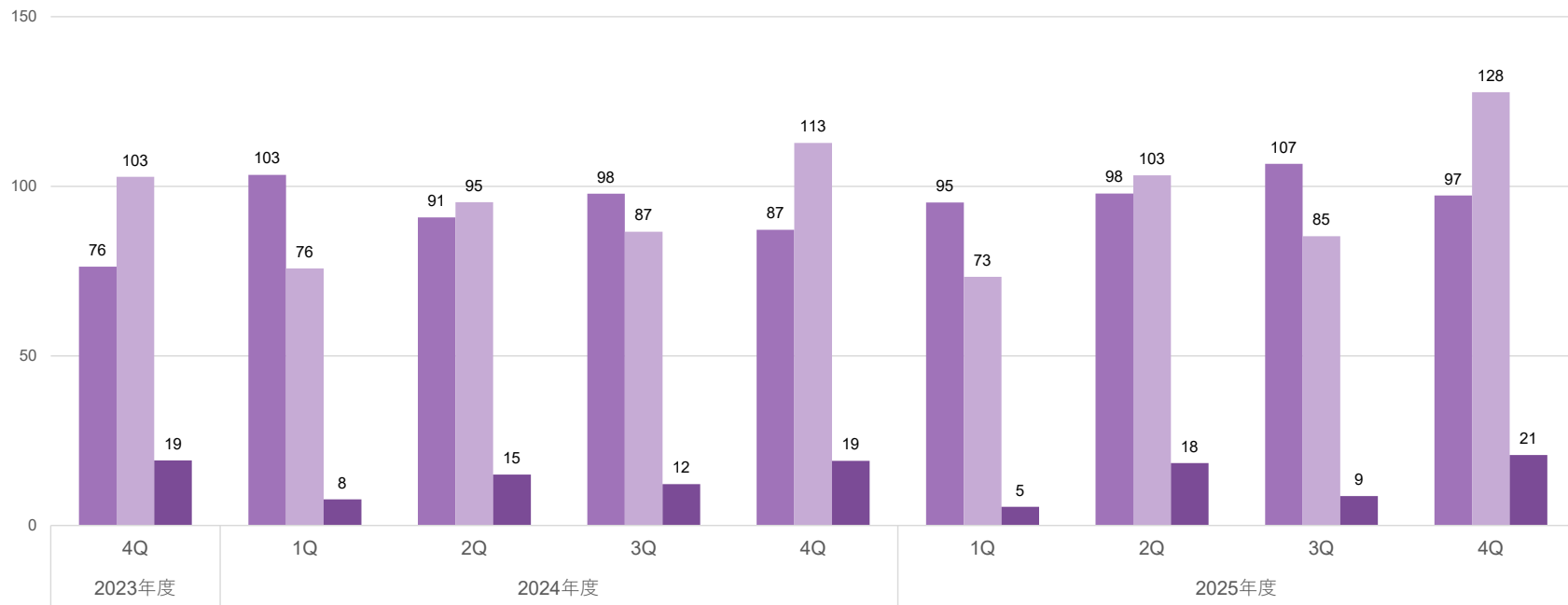
(億円) ■ 受注高 ■ 売上高 ■ 営業利益



# 計測機器セグメント 業績推移

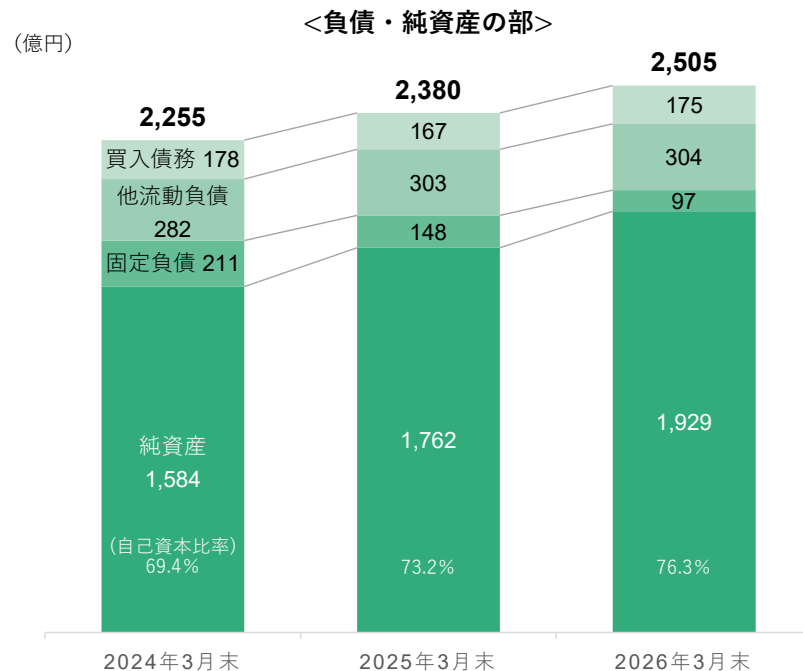
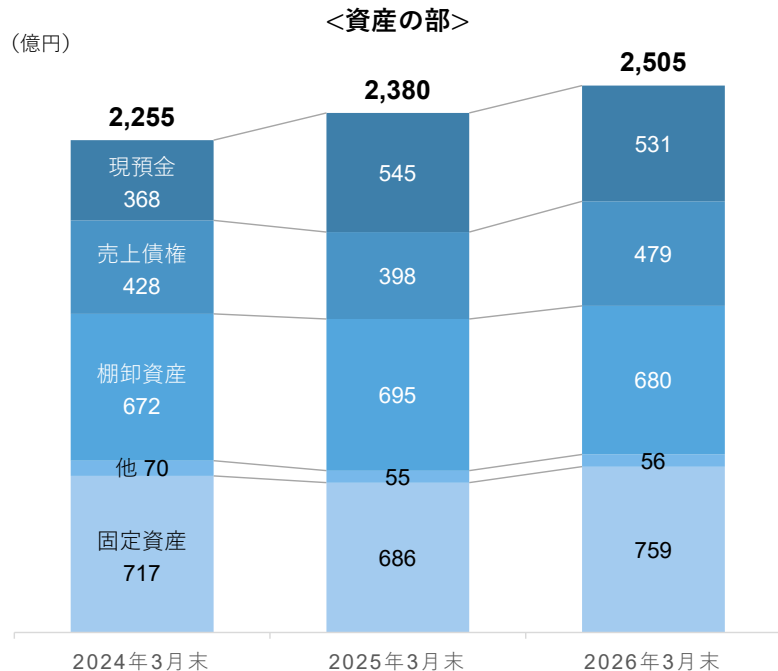
第4四半期の受注高は会社想定を上回る着地

(億円) ■ 受注高 ■ 売上高 ■ 営業利益



# 貸借対照表

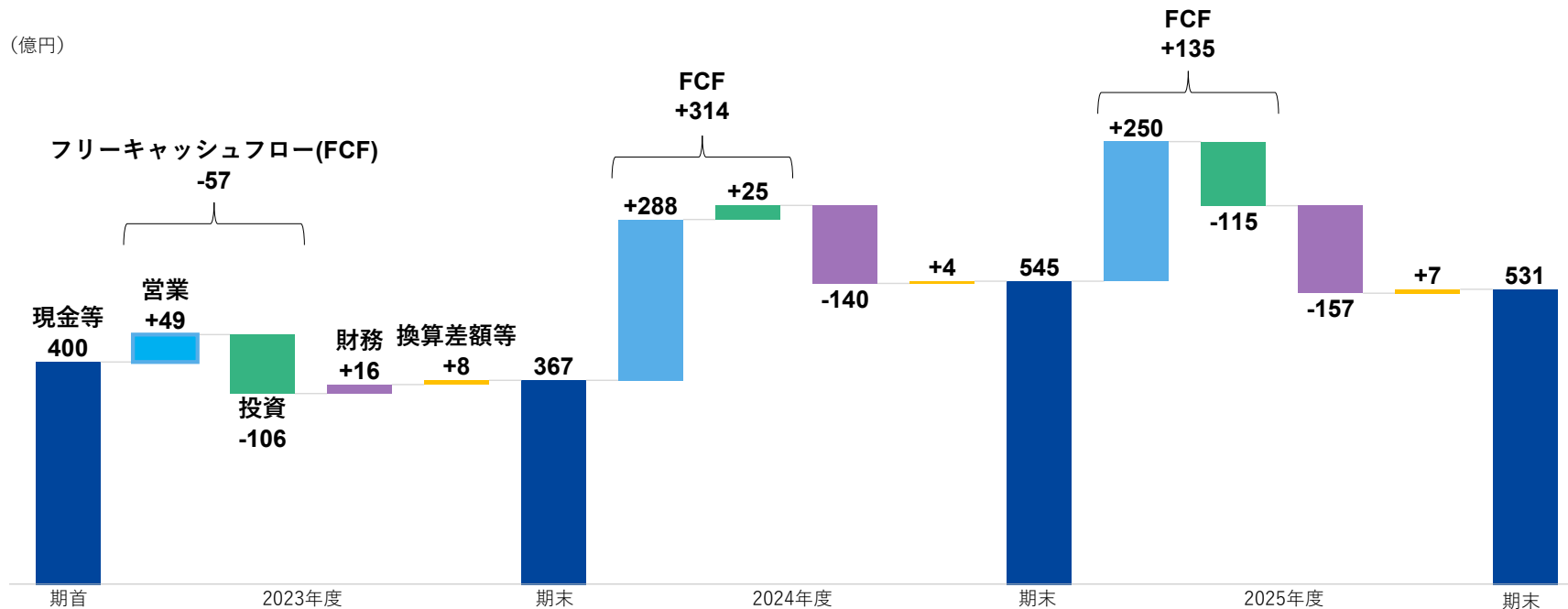
工場竣工により固定資産、売上高の増加により売上債権が増加



# キャッシュフロー

営業キャッシュフローの一定水準確保により、フリーキャッシュフローはプラス

(億円)



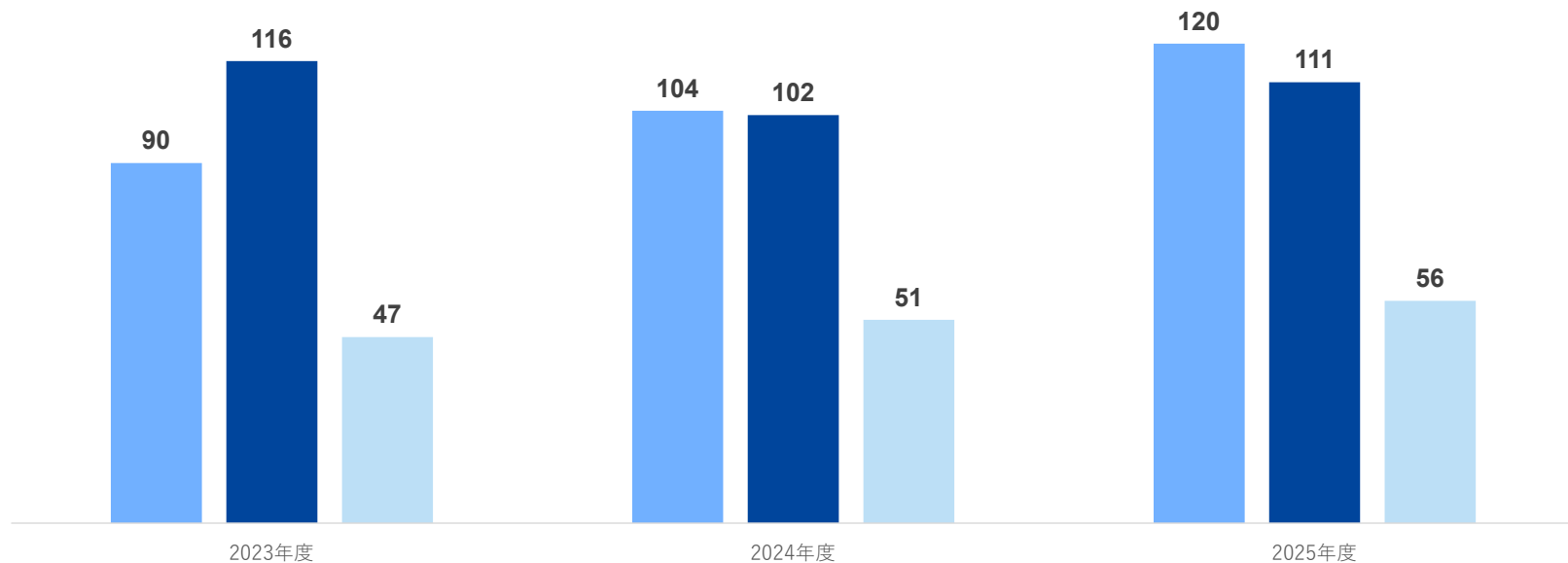


# 研究開発費・設備投資・減価償却費

将来の成長に向けた投資を着実に実行

(億円)

■ 研究開発費 ■ 設備投資 ■ 減価償却費



## 2025-2027年度 中期経営計画 初年度総括

# 中期経営計画(2025-2027年度)の位置づけ

中期経営計画(2025-2027年度)では、「長期成長に向けた準備」と「期間の成長」とを両立する

2022-  
2024年度  
(前回)

次の成長の為の布石置き

- 研究開発投資
- 生産キャパシティ拡張
- アプリケーション強化
- 環境投資

2025-  
2027年度  
(今回)

持続的成長に向けた  
足場固めとインフラ作り

- 戦略製品の成長促進
- 半導体・計測のシナジー追求
- リカーリングビジネス拡大
- 生産キャパシティ投資
- アプリケーション強化投資
- 新事業創設への始動

~2035年度  
(10年後)

当社製品・サービスが無ければ  
「モノを作れない・測れない」  
絶対的なポジション確立

- 次世代・最先端デバイスに向けた高精度な加工・測定技術の提供
- シナジーが生み出す唯一無二の技術の確立
- 顧客のあらゆる課題に対するソリューションの提供

# 中期経営計画(2025-2027年度)の基本方針

事業強化と事業基盤そのものの強化を両立させる

## 戦略製品の成長促進

- 半導体製造装置：
  - 高付加価値プローバ
  - 先端グラインダ
  - 先端ダイサ 等
- 計測機器：
  - 充放電試験システム
  - X線検査装置 等

## 計測・半導体の技術シナジー追求

- 精密計測機器をビルトインした新たな半導体製造装置
- 計測アプリケーションの半導体エリアへの応用

## リカーリングビジネス強化

- 半導体製造装置：
  - サービス/サポートビジネス強化
  - 消耗品事業拡大
  - 既設装置向け事業機会創出
- 計測機器：
  - 受託計測・評価サービス拡充
  - 機器校正サービス強化

## これらを支える事業基盤の強化

要素技術開発の強化促進

セグメント横断的な事業戦略組織

新たなチャレンジを促す環境

ITを活用した生産性向上

サステナビリティ  
マネジメントの進化

# 中期経営計画(2025-2027年度) 初年度総括 定量目標

2024年度実績に対し、約20%増収、50%増益の目標を設定

	2024年度 実績	中期経営計画期間 (2025-2027年度) 単年度
売上高	<b>1,505億円</b> 半導体1,135億円 計測371億円	<b>1,850億円</b> 半導体1,400億円 計測450億円
営業利益	<b>297億円</b> 半導体243億円 計測54億円	<b>450億円</b>
営業利益率	<b>20%</b> 半導体21% 計測15%	<b>24%</b>
ROE	<b>15%</b>	<b>15%</b>

## 前提

- 定量目標：単年目標として設定(市場ボラティリティを考慮)
- 半導体：対象市場のCAGR前提 +5%をアウトパフォーム
- 計測：非自動車(半導体, 航空, 宇宙など)の持続的な市況回復
- 営業利益：売上増(高付加価値製品を含む)  
原価低減の進展、リカーリングビジネス推進
- ROE：純利益の積み増し
- リスクファクター：
  - 民生アプリケーション需要の不確実性
  - 地政学リスク(中国の装置需要・競合等)
  - 工作機械受注の鈍化

# 中期経営計画(2025-2027年度) 初年度総括

全体方針・基本方針に沿ったアクションを着実に実行

## 戦略製品の成長促進

### 半導体：高付加価値製品の開発強化

- ・ 高精度温度制御機能付きプローバ → HPC向け需要の獲得に貢献
- ・ Hybrid Bonding用グラインダ、大型PLP向け加工装置等

### 計測：各種機器の高機能化、高付加価値化

- ・ 大型高精度測定機の展開 → 航空・宇宙・防衛分野の新規需要を獲得
- ・ オートメーション機能強化、充放電試験システムサービス強化

## 計測・半導体の 技術シナジー追求

### ソリューション提案の強化

- ・ プローバ・ダイサ・グラインダへ「計測ビルトイン」を展開
- ・ 計測機器の半導体・半導体製造装置分野への拡販強化

## リカーリングビジネス 強化

### 消耗品販売促進活動、開発強化

- ・ 特にダイシングブレードで新製品の開発・展開を強化

### サービス活動の拡大

- ・ メンテナンス、機器校正サービス提案活動強化
- ・ リカーリングビジネスのシステム管理の仕組み構築

# キャッシュアロケーション 初年度総括

将来の成長に向けた投資を着実に実行

## 研究開発投資

開発強化、3年累計で350～400億円を想定

戦略製品開発、要素技術開発、計測と半導体のシナジー技術開発  
他社との共同研究開発の推進 等

→ 初年度 投資額:120億円

高精度温度制御プローバ、先端アプリケーションに向けた  
製品力の強化

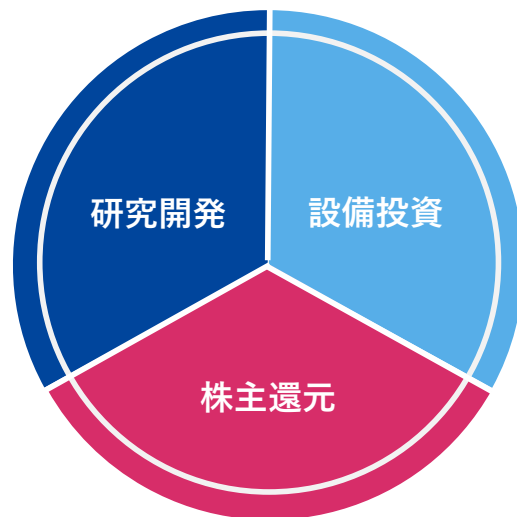
## 設備投資

将来を見据え、3年累計で累計300～400億円(\*1)を想定

- 成長投資：名古屋工場、八王子新工場、  
韓国デモセンター新設、二次電池評価機能拡張等
- 事業基盤強化：IT強化、業務効率化、ESG関連投資

→ 初年度: 111億円

名古屋工場、韓国デモセンター、二次電池評価センター  
他 中期案件として計画した投資 (飯能工場近隣地の新建屋、八王子新工場等)



(\*1) 工事進捗により変動

## 2026年度 通期業績予想



# 2026年度通期業績予想の前提

## 売上・営業利益

半導体：生成AIを含むHPC案件による売上増、メモリ・ロジック向けの引合に強い期待、通期で増収を計画

- 生成AIを含むHPC：引き続き 売上高・利益に大きく貢献 (4割程度)
- グローバルOSAT：HPC向けに加え他ロジック向けの増加を想定
- 中国需要：ハイエンド需要を中心に高水準
- 汎用メモリ：DRAM/NAND向けの出荷増加

計測：ものづくり市場全般の回復に加え、価格改定や航空・宇宙・防衛分野、半導体関連の売上増を想定

利益：引き続きコスト増圧力はあるが、高付加価値製品比率の増加・原価改善+ $\alpha$ を通じ 中期経営計画目標に近づける

## 受注動向

半導体：上期はHPC・中国向けが堅調、さらにメモリ・ロジック向けの増加を期待。下期計画は未策定だが、高水準を想定

- 生成AIを含むHPC：上期はHBM向けの増加を主因に2025年度下期比で+20%程度を想定
- グローバルOSAT：全般に引き合いが強まる
- 中国需要：ハイエンド需要が継続すると想定
- 汎用メモリ：DRAM/NAND向けの引合いが加速

計測：航空・宇宙・防衛分野、半導体関連需要の増加、及び補助金の活用による引合増加を想定

## 2026年度通期業績予想

下期も堅調な事業環境が想定されるが、合理的に見積もることが可能な範囲内で業績予想を作成  
特に半導体製造装置の高付加価値製品(プローバ)がけん引し、増収増益となる想定  
前提為替レートは150円/ドル (為替変動影響は軽微：円建て比率高)

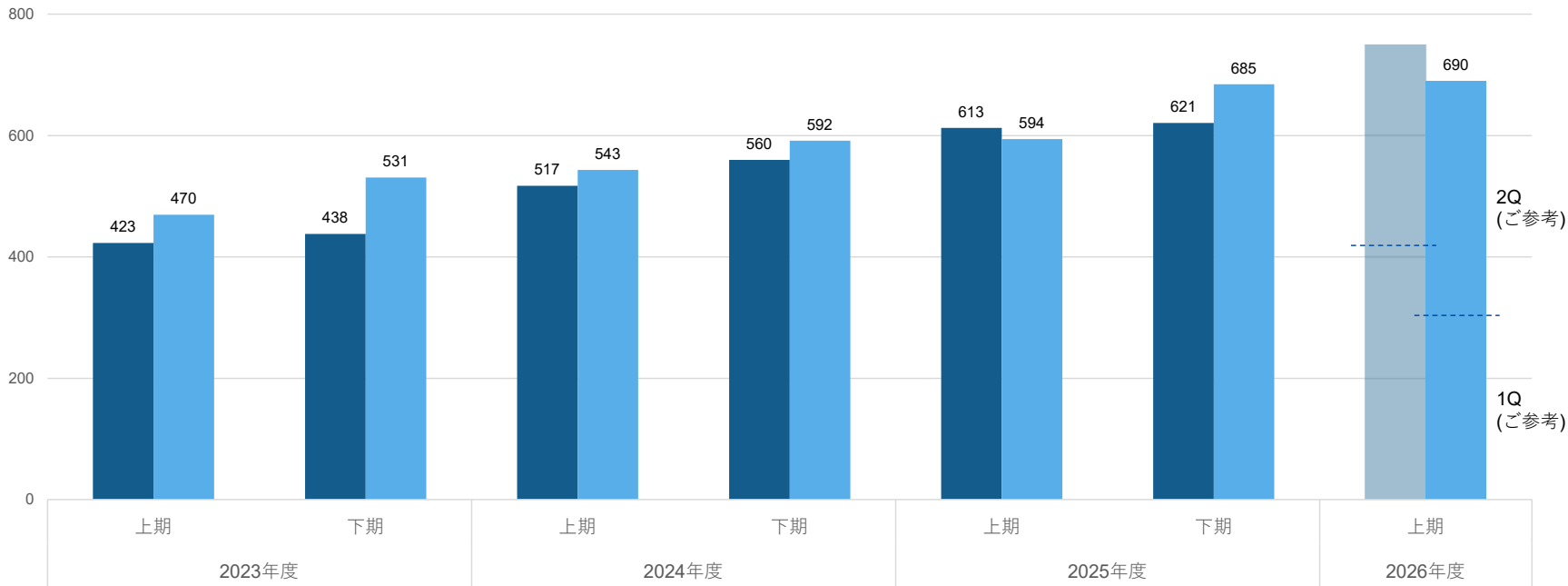
全社業績(億円)	2025年度 上期	2025年度 下期	2025年度 通期	2026年度 上期予	2026年度 下期予	2026年度 通期予	前期比
受注高	806	825	1,631	-	-	-	-
売上高	771	898	1,668	875	940	1,815	+9%
営業利益	147	190	337	187	213	400	+19%
(利益率)	(19%)	(21%)	(20%)	(21%)	(23%)	(22%)	+2pt
経常利益	150	199	348	187	213	400	+15%
当期純利益	96	151	247	131	149	280	+13%
研究開発費	55	65	120	-	-	130	+8%
設備投資	69	42	111	-	-	110	-1%
減価償却費	27	29	56	-	-	62	+11%
セグメント売上高	2025年度 上期	2025年度 下期	2025年度 通期	2026年度 上期予	2026年度 下期予	2026年度 通期予	前期比
半導体製造装置	594	685	1,279	690	725	1,415	+11%
計測機器	177	213	390	185	215	400	+3%
1株配当(円)	111円	151円	262円	138円	138円	276円	+14円

# 半導体製造装置セグメントー 売上・受注高 半期見込

2026年度上期受注高は前年同期比で20%増を想定

(億円)

■ 受注高 ■ 売上高

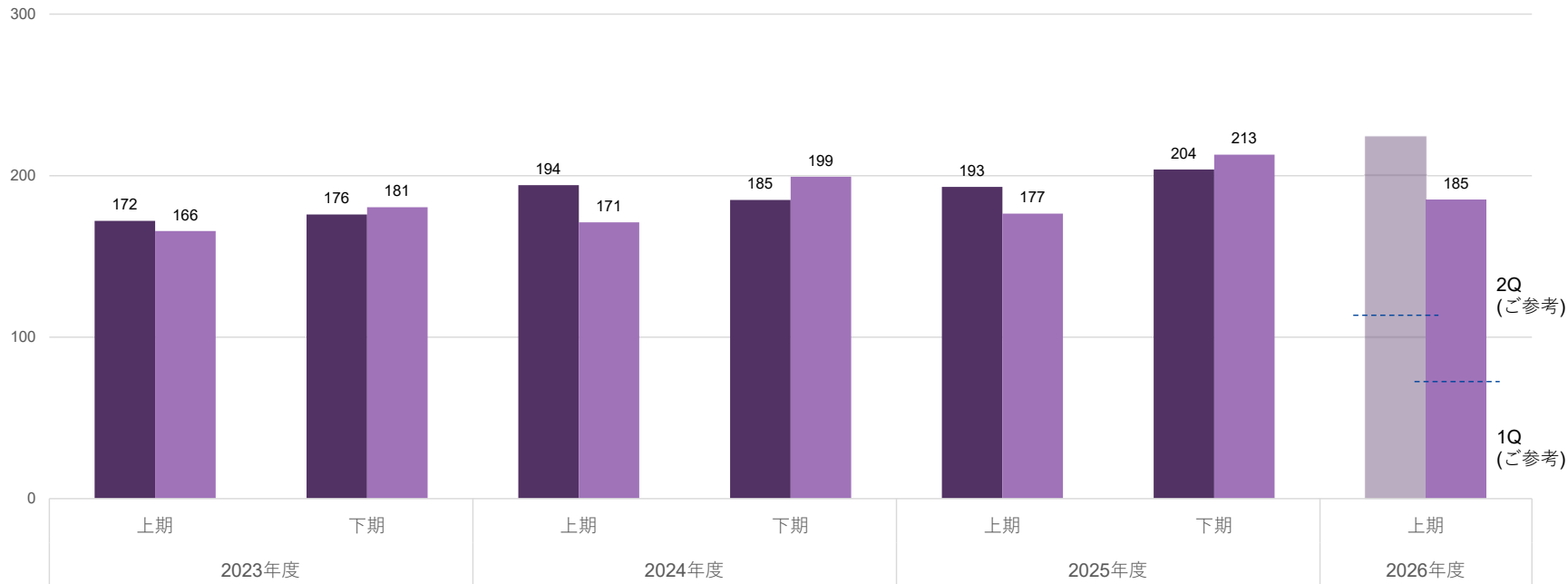


# 計測機器セグメント – 売上・受注高 半期見込

2026年度上期受注高は前年同期比で10%増を想定

(億円)

■ 受注高 ■ 売上高



## 質疑応答 / Q&A

# Supplementary Data - 生成AIを含むHPC / HPC-related business incl. Gen.AI

## <売上高/Sales>

(前半期比増減率 / HoH Changes)	2025年度上期 FY2026/3 1H	2025年度下期 FY2026/3 2H	2026年度上期予 FY2027/3 1H (f)
生成AIを含むHPC 全体 HPC-related incl. Gen. AI	前半期比 +55% HoH	前半期比 +32% HoH	前半期比 +18% HoH
うちロジック (生成AIを含む) of which Logic (incl. Gen AI)	前半期比 +81% HoH	前半期比 +11% HoH	前半期比 +1% HoH
うちHBM of which HBM	前半期比 +28% HoH	前半期比 +64% HoH	前半期比 +35% HoH
SPE売上高に占めるHPC関連の割合 HPC-related proportion of total SPE sales	30%強 / Low 30%	30%半ば / Mid-30%	40%強 / Low 40%

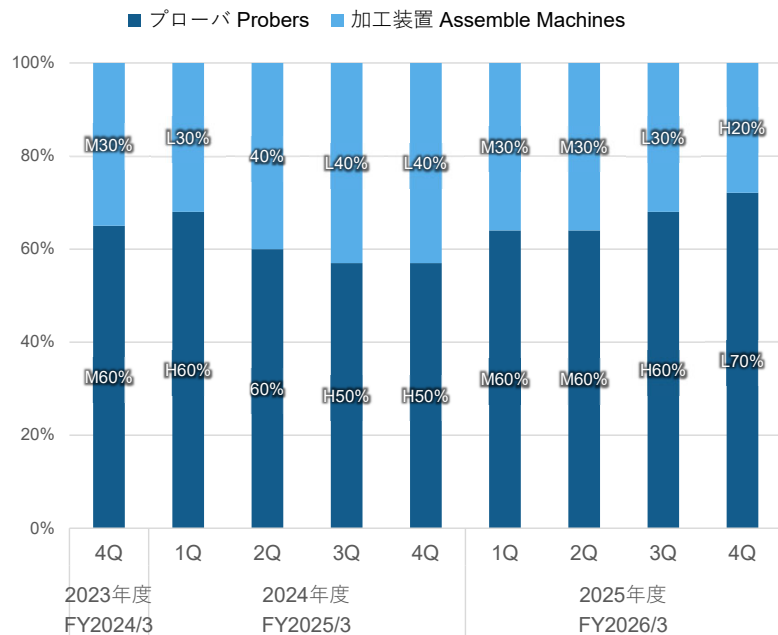
## <受注高/Orders>

(前半期比増減率 / HoH Changes)	2025年度上期 FY2026/3 1H	2025年度下期 FY2026/3 2H	2026年度上期予 FY2027/3 1H (f)
生成AIを含むHPC 全体 HPC-related incl. Gen. AI	前半期比 +24% HoH	前半期比 +4% HoH	前半期比 +15% HoH
うちロジック (生成AIを含む) (*) of which Logic (incl. Gen AI) (*)	前半期比 -11% HoH	前半期比 +84% HoH	前半期比 -16% HoH
うちHBM of which HBM	前半期比 +65% HoH	前半期比 -48% HoH	前半期比 +88% HoH
SPE受注高に占めるHPC関連の割合 HPC-related proportion of total SPE orders	40%	40%	40%強 / Low 40%

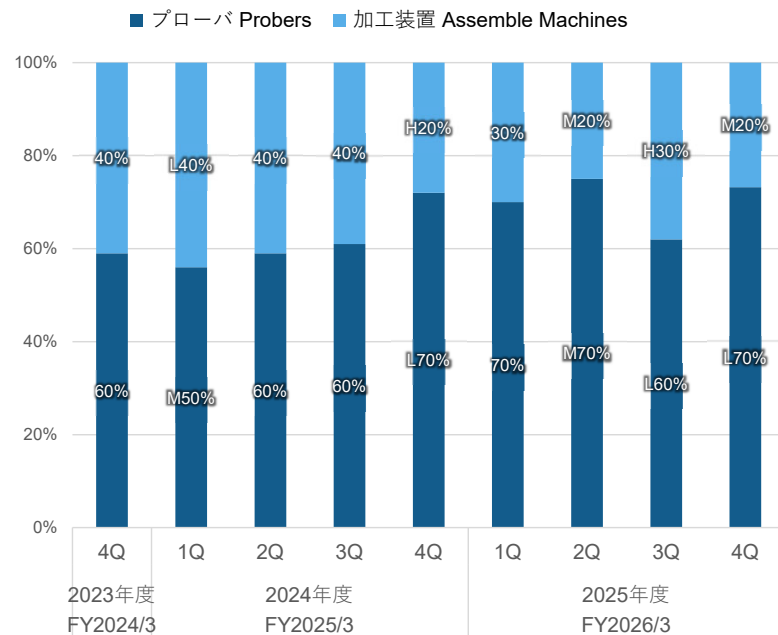
- 変動が大きいため、四半期別の開示は行っておりません。 Due to significant volatilities, the Company does not provide quarterly forecasts.
- 『生成AIを含むHPC全体』は、「うちロジック(生成AIを含む)」および「うちHBM」の合計です。「うちロジック(生成AIを含む)」には、ロジックデバイス向けプローバやAIパッケージング向けの加工装置の需要が含まれています。なお、当社は製品の特性上、検査や加工がおこなわれる半導体デバイスの種別を特定することが困難であることから、生成AIに限定した分類は行っておりません。“HPC-related incl. Gen.AI” represents the sum of ‘of which Logic (incl. Gen.AI)’ and ‘of which HBM’. The ‘of which Logic (incl. Gen. AI)’ encompasses businesses for probers for logic devices and assembly equipment for AI packaging. Note that due to the nature of our products, it is difficult to identify the specific types of semiconductor devices undergoing inspection or processing; consequently, the Company does not undertake classification limited solely to Generative AI.

# Supplementary Data - 製品別構成比 半導体 / SPE Segment per Product

<売上高 Sales>



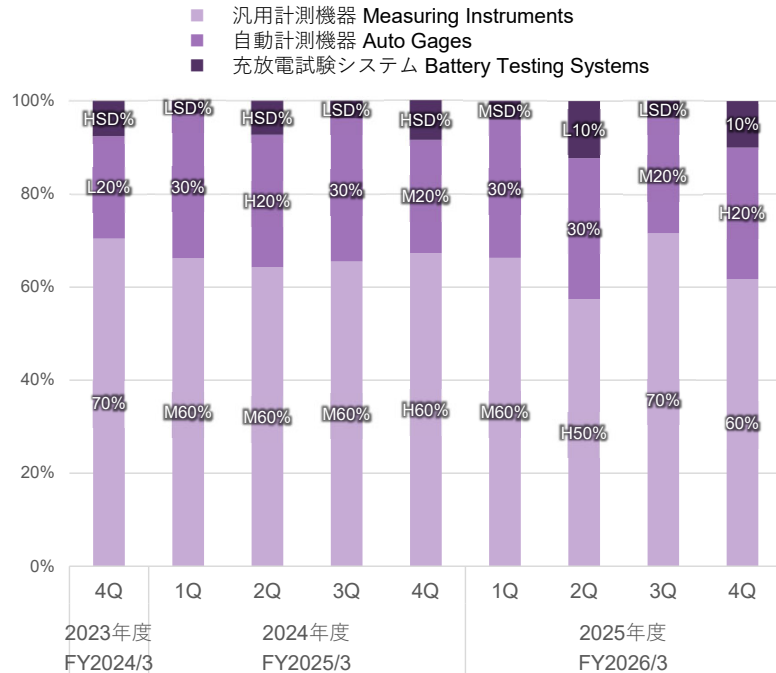
<受注高 Orders>



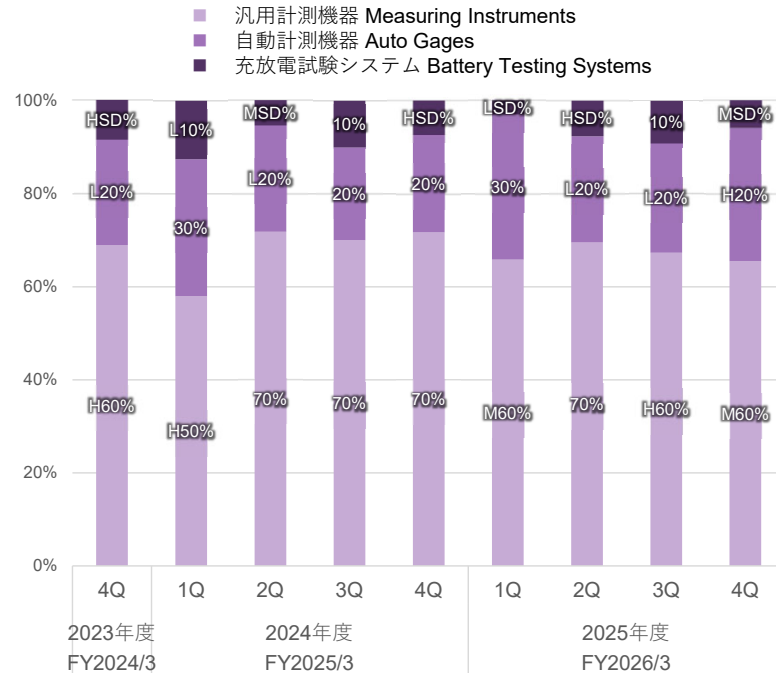
%表記：L:Low(前半), M:Middle(半ば), H:High(後半)、0-3%:LSD(Low Single Digit)、4-6%:MSD% (Mid Single Digit)、7-8%:HSD% (High Single Digit)

# Supplementary Data - 製品別構成比 計測 / Metrology Segment per Product

<売上高 Sales>



<受注高 Orders>

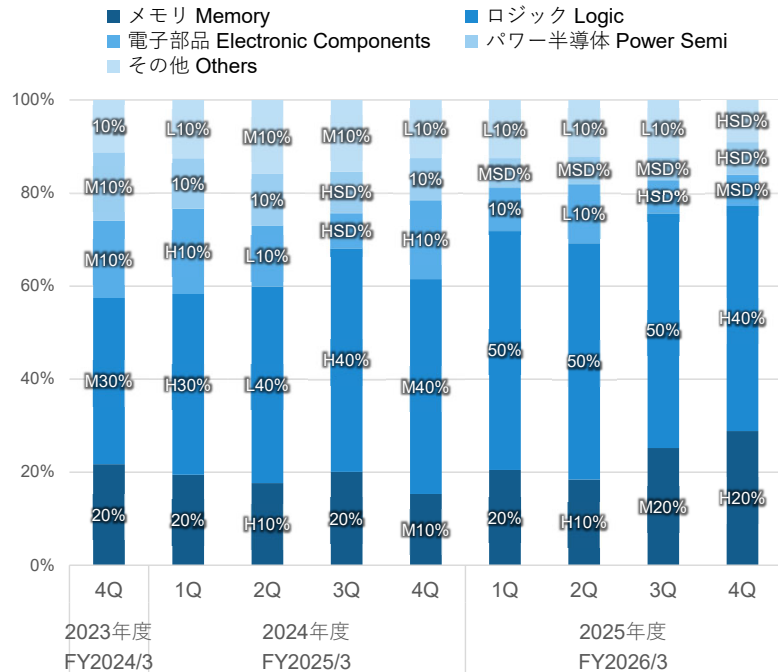


%表記 : L:Low(前半), M:Middle(半ば), H:High(後半)、0-3%:LSD(Low Single Digit)、4-6%:MSD% (Mid Single Digit)、7-8%:HSD% (High Single Digit)

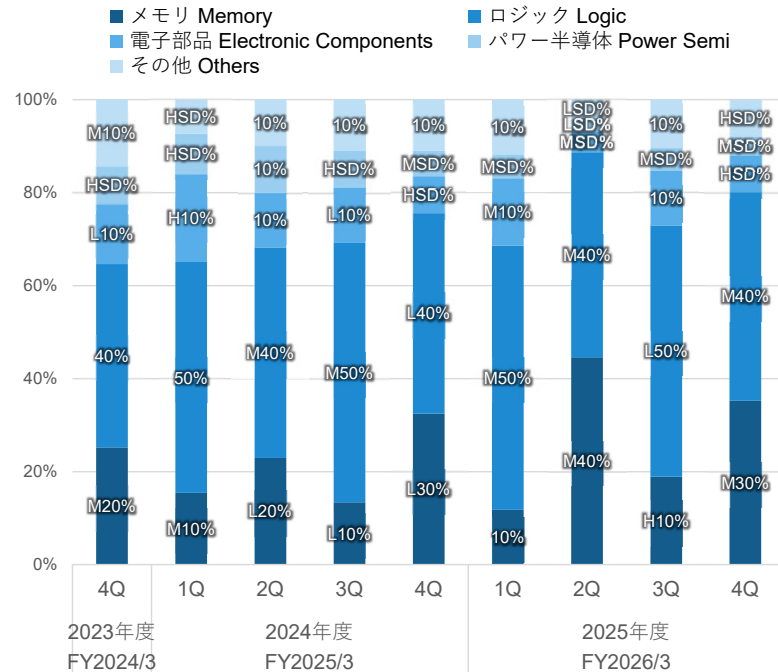


# Supplementary Data - アプリ別構成比 半導体 / SPE Segment per Application

<売上高 Sales>



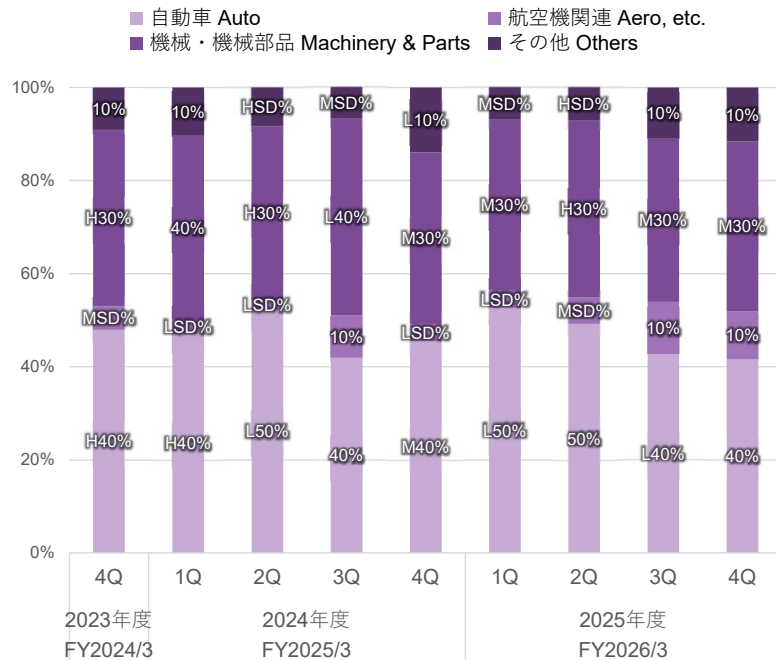
<受注高 Orders>



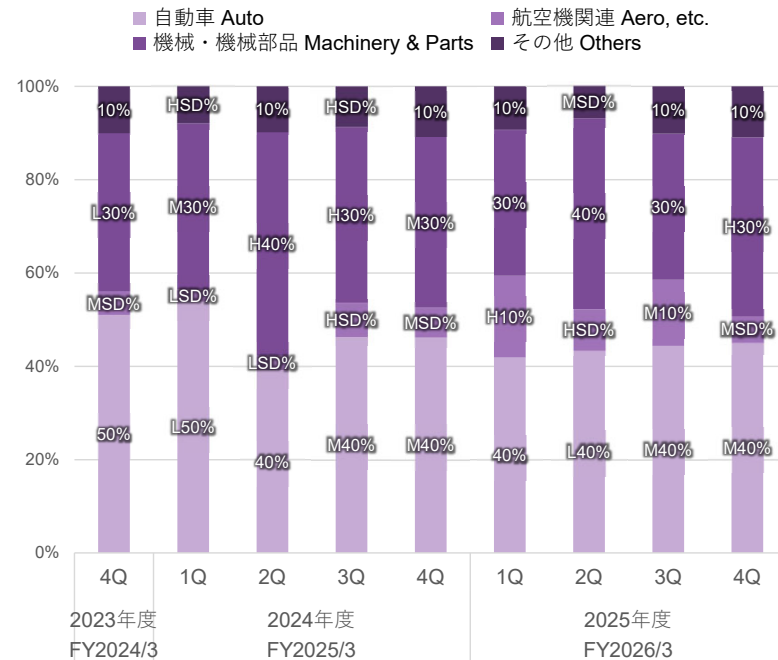
%表記 : L:Low(前半), M:Middle(半ば), H:High(後半)、0-3%:LSD(Low Single Digit)、4-6%:MSD% (Mid Single Digit)、7-8%:HSD% (High Single Digit)

# Supplementary Data - アプリ別構成比 計測 / Metrology Segment per Application

<売上高 Sales>



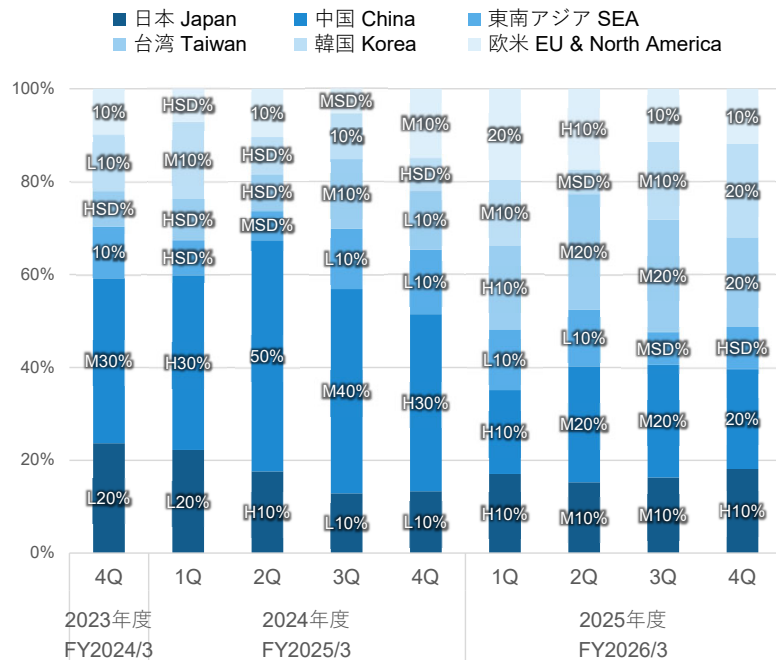
<受注高 Orders>



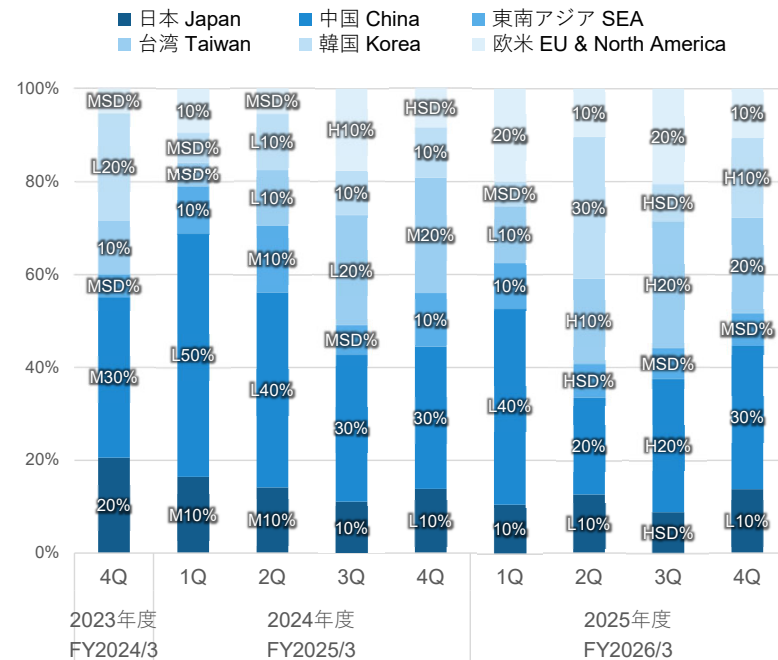
%表記 : L:Low(前半), M:Middle(半ば), H:High(後半)、0-3%:LSD(Low Single Digit)、4-6%:MSD% (Mid Single Digit)、7-8%:HSD% (High Single Digit)

# Supplementary Data - 地域別構成比 半導体 / SPE per Region

<売上高 Sales>



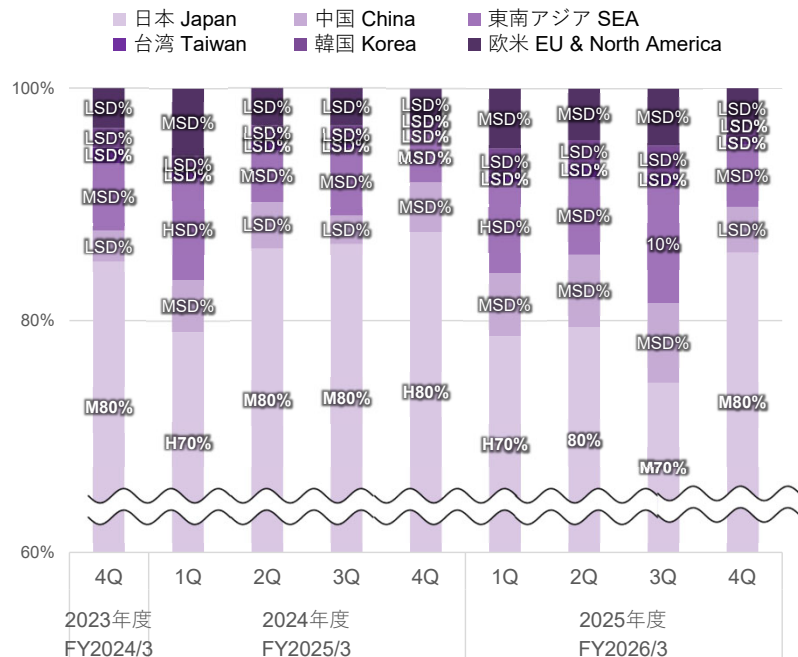
<受注高 Orders>



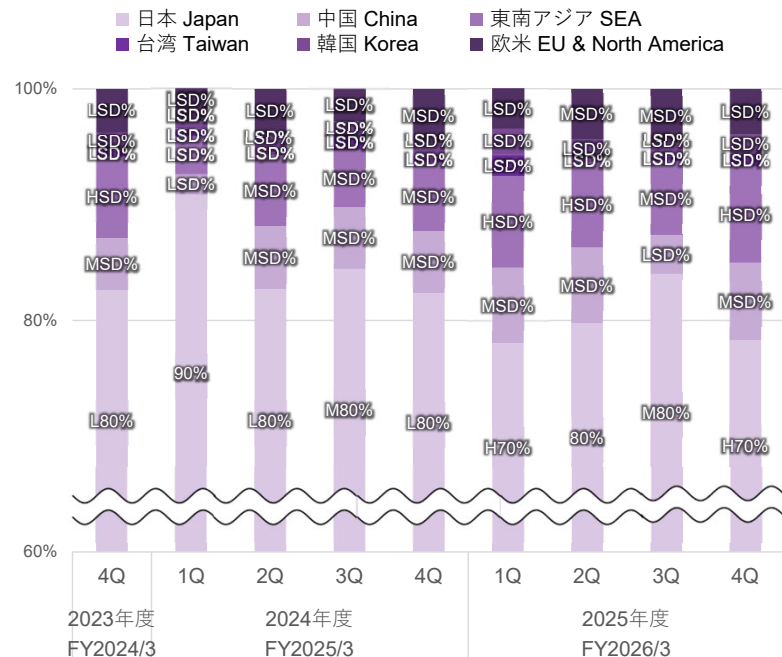
%表記 : L:Low(前半), M:Middle(半ば), H:High(後半)、0-3%:LSD(Low Single Digit)、4-6%:MSD% (Mid Single Digit)、7-8%:HSD% (High Single Digit)

# Supplementary Data - 地域別構成比 計測 / Metrology per Region

<売上高 Sales>



<受注高 Orders>



%表記: L:Low(前半), M:Middle(半ば), H:High(後半)、0-3%:LSD(Low Single Digit)、4-6%:MSD% (Mid Single Digit)、7-8%:HSD% (High Single Digit)

(注) 取引顧客の国籍による分類であり、日本向け売上高・受注高には、第3国への輸出案件が含まれています。This data classifies based on customers' nationality. Sales and orders for Japan include export transactions to third countries.

# Supplementary Data - セグメント別業績推移 / Segment Information

(百万円) Million Yen		会計期間 Fiscal Year				四半期 Quarter							
		2022年 3月期 FY2022/3	2023年 3月期 FY2023/3	2024年 3月期 FY2024/3	2025年 3月期 FY2025/3	2025年3月期 FY2025/3				2026年3月期 FY2026/3			
						1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
受注増	半導体 SPE	152,896	99,366	86,082	107,713	27,081	24,631	29,456	26,544	26,378	34,945	25,965	36,106
	計測 Metr.	33,159	36,960	34,802	37,917	10,336	9,082	9,781	8,717	9,523	9,786	10,661	9,728
	合計 Total	186,056	136,326	120,885	145,631	37,417	33,713	39,237	35,262	35,901	44,732	36,627	45,835
受注残高	半導体 SPE	102,370	89,371	75,398	69,630	80,433	72,785	79,205	69,630	72,466	71,541	70,134	65,149
	計測 Metr.	9,904	12,428	12,606	13,470	15,362	14,911	16,031	13,470	15,660	15,123	17,257	14,210
	合計 Total	112,274	101,799	88,004	83,101	95,796	87,697	95,236	83,101	88,127	86,664	87,391	79,359
売上高	半導体 SPE	101,145	112,365	100,055	113,481	22,046	32,280	23,036	36,118	23,542	35,870	27,372	41,092
	計測 Metr.	29,556	34,436	34,624	37,053	7,580	9,532	8,661	11,278	7,333	10,323	8,528	12,775
	合計 Total	130,702	146,801	134,680	150,534	29,626	41,812	31,698	47,397	30,876	46,194	35,900	53,867
営業利益	半導体 SPE	24,698	29,866	19,899	24,311	3,314	7,824	4,449	8,722	4,031	8,297	5,347	10,727
	計測 Metr.	3,628	4,628	5,408	5,392	768	1,497	1,220	1,905	549	1,838	867	2,077
	合計 Total	28,327	34,494	25,307	29,703	4,083	9,322	5,670	10,627	4,581	10,136	6,214	12,805
営業利益率	半導体 SPE	24.4%	26.6%	19.9%	21.4%	15.0%	24.2%	19.3%	24.1%	17.1%	23.1%	19.5%	26.1%
	計測 Metr.	12.3%	13.4%	15.6%	14.6%	10.1%	15.7%	14.1%	16.9%	7.5%	17.8%	10.2%	16.3%
	合計 Total	21.7%	23.5%	18.8%	19.7%	13.8%	22.3%	17.9%	22.4%	14.8%	21.9%	17.3%	23.8%

# Supplementary Data - 損益計算書 / Income Statement

(百万円) Million Yen	会計期間 Fiscal Year				四半期 Quarter							
	2022年 3月期 FY2022/3	2023年 3月期 FY2023/3	2024年 3月期 FY2024/3	2025年 3月期 FY2025/3	2025年3月期 FY2025/3				2026年3月期 FY2026/3			
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
売上高 Net Sales	130,702	146,801	134,680	150,534	29,626	41,812	31,698	47,397	30,876	46,194	35,900	53,867
売上原価 Cost of goods sold	77,694	84,967	79,917	88,081	17,753	24,757	17,960	27,609	18,468	27,411	21,063	31,034
売上総利益 Gross Profit on Sales	53,008	61,834	54,762	62,453	11,873	17,054	13,738	19,787	12,407	18,783	14,837	22,832
販売費および一般管理費 Selling, general and administrative expenses	24,681	27,339	29,454	32,750	7,790	7,732	8,067	9,159	7,825	8,647	8,622	10,026
営業利益 Operating profit	28,327	34,494	25,307	29,703	4,083	9,322	5,670	10,627	4,581	10,136	6,214	12,805
営業外収益 Non-operating income	987	965	1,404	921	287	39	539	55	133	309	609	428
営業外費用 Non-operating expenses	153	162	259	684	41	531	-422	534	252	-69	84	126
経常利益 Recurring Profit	29,160	35,297	26,453	29,939	4,329	8,829	6,632	10,148	4,462	10,515	6,739	13,108
特別利益 Extraordinary gains	390	103	824	4,493	10	4,483	0	0	3	85	105	0
特別損失 Extraordinary losses	34	2,099	21	158	-	-	157	0	-	2,103	-	-269
税引前利益 Profit before income taxes and minority interests	29,516	33,301	27,255	34,275	4,339	13,312	6,474	10,148	4,465	8,498	6,844	13,377
法人税等合計 Total income tax and others	8,132	9,607	7,791	8,531	754	3,310	1,870	2,596	1,228	2,090	2,268	2,768
非支配株主に帰属する四半期純利益 Net Profit attributable to minority interests	57	62	84	106	31	6	29	39	7	25	39	18
親会社株主に帰属する当期純利益 Net Profit attributable to Owners of the Parent	21,326	23,630	19,378	25,637	3,554	9,996	4,574	7,512	3,229	6,382	4,536	10,590
1株当たり当期純利益(円) Net Profit per Share (Yen)	522.52	581.33	480.49	633.75	87.89	247.09	113.07	185.67	79.77	157.32	112.74	260.73
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) Net Profit per Share (diluted) (Yen)	517.51	575.62	475.42	628.31	-	-	-	-	-	-	-	-

# Supplementary Data - 貸借対照表 / Balance Sheet

(百万円) (Million Yen)		2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2026年3月期 FY2026/3
流動資産 Current Assets	現金及び預金 Cash and cash equivalents	40,080	36,782	54,541	53,073
	売上債権※1 Accounts Receivable※1	43,403	42,801	39,809	47,877
	棚卸資産 Inventories	53,482	67,225	69,513	68,022
	その他 Others	7,005	7,022	5,477	5,634
	合計 Total	143,972	153,831	169,341	174,607
固定資産合計 Total Fixed Assets		65,060	71,693	68,610	75,925
総資産 Total Assets		209,032	225,524	237,952	250,533
流動負債 Current Liabilities	買入債務※2 Accounts Payable※2	22,359	17,845	16,665	17,529
	その他 Others	28,588	28,156	30,268	30,350
	合計 Total	50,947	46,002	46,933	47,879
固定負債合計 Total long-term liabilities		12,057	21,094	14,789	9,737
負債合計 Total Liabilities		63,004	67,097	61,723	57,617
純資産合計 Total Net Assets		146,028	158,427	176,229	192,916
負債・純資産合計 Total Liabilities and Net Assets		209,032	225,524	237,952	250,533
有利子負債合計 Total interest-bearing debt		14,191	25,171	20,084	14,713
自己資本比率 Equity Ratio(%)		69.0%	69.4%	73.2%	76.3%
自己資本利益率 ROE(%)		17.3%	12.9%	15.5%	13.5%

※1: 電子記録債権、契約資産を含む  
Incl. Electronically recorded monetary claims

※2: 電子記録債務を含む  
Incl. Electronically recorded obligations-operating

# Supplementary Data - 各種費用, キャッシュフロー/ Expenses and Cash

(百万円) (Million Yen)	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2026年3月期 FY2026/3
研究開発費 R&D expenses	8,542	9,042	10,354	12,037
設備投資 Capex	9,725	11,602	10,245	11,069
減価償却費 (のれんの償却を除く) Depreciation (excl. Amortization of goodwill)	3,832	4,673	5,105	5,582

(百万円) (Million Yen)	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2025年3月期 FY2026/3
営業活動によるキャッシュフロー Cash flows from operating activities	1,000	4,892	28,824	25,012
投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities	-8,421	-10,563	2,541	-11,491
フリーキャッシュフロー Free cash flows	-7,421	-5,671	31,365	13,520
財務活動によるキャッシュフロー Cash flows from financing activities	-2,174	1,616	-13,991	-15,674
現金及び現金同等物に係る換算差額等 Adjustments	625	755	404	689
現金及び現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents at the end of year	40,036	36,736	54,516	53,052

(人数) (# of People)	2023年3月期 FY2023/3	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2026年3月期 FY2026/3
正社員合計 Total regular employees	2,468	2,658	2,767	2,890
臨時従業員 年間平均雇用人員数 (※1) Average number of part-time employees, not included in the above figure	1,258	1,225	1,258	1,365
従業員合計 (※1) Number of employees	3,726	3,883	4,025	4,255

※1: 従前の補足資料では、臨時従業員数の期末の実数を表記しておりましたが、年間平均数に改めております。また従業員合計は、正社員合計人数と、期間平均臨時従業員数の単純合算です。  
In previous supplementary documents the number of temporary employees was given as the actual number at the end of each fiscal term. However, this has been revised to the average number for each period. Therefore, "Number of employees" is a simple sum of the total number of regular employees and the average number of temporary employees during the period.



# Supplementary Data - (ご参考) 2026年度 東京精密 マテリアリティ

青字: 2026年度変更

テーマ (合計 6テーマ)	マテリアリティ (合計 23マテリアリティ)
豊かな社会の実現に貢献	社会課題を解決する製品の創出と提供
	未来を創り社会を豊かにする半導体製造への貢献
	精密測定を通じたモノづくりのイノベーションへの貢献
持続可能な社会づくりに貢献する 事業活動の推進	バリューチェーンにおける温室効果ガスの削減
	地球環境に貢献する製品の創出と提供
	環境保全と資源管理の最適化
	サーキュラー・エコノミーの実現
	環境マネジメントシステムの高度化
ステークホルダーの信用・信頼に応える 企業姿勢の維持・強化	バリューチェーンにおけるサステナビリティの推進
	製品品質と安定供給の確保及びカスタマーサポートの充実
	ステークホルダーエンゲージメントの推進
多様な人々が前向きに活々と働ける 職場環境の醸成	多様な視点と価値観の尊重
	心身ともに健康で安全に働ける職場づくり
	従業員エンゲージメントの向上
	コーポレート・ガバナンスの強化
公正な企業活動の基盤となるガバナンスの強化	コンプライアンスの強化
	リスクマネジメントの推進
	人財の確保と育成の推進
事業基盤の強化	研究開発力の強化
	知的財産の管理と活用
	DXの推進
	変革を支える企業風土の醸成
	持続可能な安定経営の実現